


CEOインタビュー

代表取締役社長・CEO
河合 利樹

半導体・ディスプレイ産業は 一段上の成長フェーズへ

各製品の強みを融合した革新的な技術で、顧客ニーズに応える

Question

01

2017年3月期は、過去最高益更新となる素晴らしい業績となりましたが、CEOにご就任されてからの成果や取り組みについてお聞かせください。

注力分野における当社装置がお客さまに高く評価されたことで、市場シェアが向上しました。豊富な製品ラインアップを生かした技術提案を推進するなど、2020年3月期までの中期経営計画の目標に向けた施策が順調に進捗しています。

2015年に中期経営計画を策定して以来、グローバル水準の収益力をもつ企業を目指すべく、製品競争力・顧客対応力・生産性という3つの強化項目を念頭に、強固な経営基盤ならびに技術基盤の構築を行ってきました。

これまでの成果として、注力しているエッチング・成膜・洗浄の分野を中心に、お客さまに当社装置の性能が高く評価され、より多くの製造工程において量産採用が決まりました。その結果、すべての注力分野でシェアが向上し、お客さまにおける当社の価値も確実

CEOインタビュー

に向上していると感じています。

中長期的な成長の観点からは、まず、お客さまの研究開発部門との技術交流をこれまで以上に深めることで、最先端のデバイス開発における課題をいち早く把握し、強い次世代製品を創出していくための技術開発を加速してきました。また、営業マーケティングと技術開発のそれぞれで、お客さまごとに担当ジェネラルマネージャーを設け、豊富な製品ラインアップを有する当社の優位性を生かした技術提案を従来以上に可

能とすることで、顧客対応力のいっそうの強化を図ってきました。その一環として、新たにプロセスインテグレーションセンターを設立し、主に次世代パターンング技術の開発体制を強化しました。

このように、足元の注力分野における市場シェアの上昇と、中長期的な視点での取り組みの双方により、中期経営計画の目標に向けた施策が順調に進捗しています。

Question
02

半導体やディスプレイの市場は、今後どのような成長が期待されているのでしょうか？

IoTの到来で半導体・ディスプレイの用途が飛躍的に拡大することにより、SPE*・FPD**製造装置市場はいま新たな成長フェーズを迎えています。

半導体の需要がPCなどの単一製品により3、4年周期で増減を繰り返していた、かつてのシリコンサイクルの時代とは異なり、あらゆるモノがネットワークにつながるIoT時代を迎え、半導体の用途は急速な拡がりを見せています。

近い将来には、IoT社会のインフラである次世代通信規格5Gの導入により、膨大なデータがクラウドに送られデータセンターで即時処理されていきます。さらに、AI(人工知能)や自動運転、遠隔医療、フィンテックなどの新たな技術とサービスの本格化に伴って、これらの基盤となる半導体が担う役割は増すばかりです。

このようなデータ通信量の飛躍的な増加と半導体の用途の多様化により、SPE市場は、今まさに新たな成長フェーズを迎えています。

ディスプレイ業界においても、大型有機ELテレビ、車載用パネル、ARやVRで用いられるヘッドマウントディスプレイ、デジタルサイネージなど、ディスプレイの用途の多様化に伴って、高精細化や大型化、低消費電力化、フレキシブルという技術革新が求められてきており、市場の拡大が始まっています。

* SPE: 半導体製造装置

** FPD: フラットパネルディスプレイ

Question
03

市場が新たな成長フェーズを迎えているとのことですが、その変化を、どのように事業拡大に結びつけていくのでしょうか？

お客さまが抱える高度な技術的課題に対し、当社の製品開発力と顧客対応力を磨き、さらなる付加価値を提供していきます。

半導体デバイスの高性能化、高速化、低消費電力化への要求に伴い、先端パターンングや新構造、新材料への挑戦など、半導体製造装置メーカーに対する技術革新への期待はますます高まっています。その期待に応えられる企業は限られていますが、高度な技術課題に対して幅広くソリューションを提案できる当社

にとっては、大きなビジネスチャンスです。最先端のコア技術と豊富な製品ラインアップという強みを生かし、最適なインテグレーションの提案を行っていきます。引き続き、高い製品開発力と顧客対応力により、事業の拡大に結びつけてまいります。

CEOインタビュー

中期経営計画の目標を引き上げ、市場成長を大きく上回る業績の拡大に向けて果敢に挑戦してまいります。

市場規模の一段の拡大に伴い、2017年5月末の中期経営計画の進捗発表において、当社が目指す財務モデルの前提となるWFE***（半導体前工程製造装置）市場規模をこれまでの370億ドルから450億ドルへ、売上目標を9,000億円から1兆2,000億円へと大幅に引き上げました。

当社の主要製品のエッチング装置事業では、今後特に市場の拡大が予想されていますが、物流棟の建設による生産効率の向上、生産能力の増強に着手しており、シェアの向上も含めた売上拡大への布石を打っています。さらに、新たに開発棟を建設し、高い

付加価値を持つエッチング技術を開発していきます。

また、市場が大きく、ビジネス拡大の余地も大きい成膜事業のさらなる強化を狙い、山梨と東北にある製造子会社を合併し、技術の融合と効率化を推進していきます。プロセスインテグレーション機能もさらに強化し、デバイス構造がより複雑になる次世代向けの製品開発を加速していきます。

今後も技術革新による高い価値創出が見込める製造装置事業において、製品・サービスをいっそう差別化することにより、グローバル水準の高収益企業を目指していきます。

目標とする財務モデル

WFE 市場規模	420億ドル	450億ドル
売上高	1兆500億円	1兆2,000億円
営業利益率	24%	26%
ROE(自己資本利益率)	20~25%	

*** WFE (Wafer fab equipment) : 半導体前工程製造装置。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

Question
04

強固なバランスシート、高いキャッシュ創出力をお持ちですが、手元資金はどのように活用されるお考えでしょうか？

成長への投資と株主還元をバランス良く行い、さらなる利益成長と企業価値の最大化を目指します。

利益の追求は、企業の持続的成長に欠かせないものです。創出した利益は第一に、当社のさらなる成長を目指し、革新的な技術の創出に向けて再投資していきます。

当社が参入している業界は新しい成長フェーズを迎え、当社が研究開発すべき技術領域はこれまで以上に広がっています。一方で、開発のためのリソースは無限ではありません。個々の開発項目について、それがもたらす付加価値を十分に吟味し、開発リソースの選択と集中を適切に行ってまいります。

株主還元については、中期経営計画を発表した2016年3月期に、配当性向を50%に引き上げるとともに1株当たりの年間配当金の下限を150円に設定しました。当期は、1株当たり年間配当額は過去最高を更新することができました。自己株式取得については、成長への投資や手元資金の水準、マクロ経済の動向などを総合的に勘案し、機動的に実施を検討していきます。

今後も中期経営計画の達成とさらなる企業価値の向上により、株主の皆さまの期待に応えてまいります。